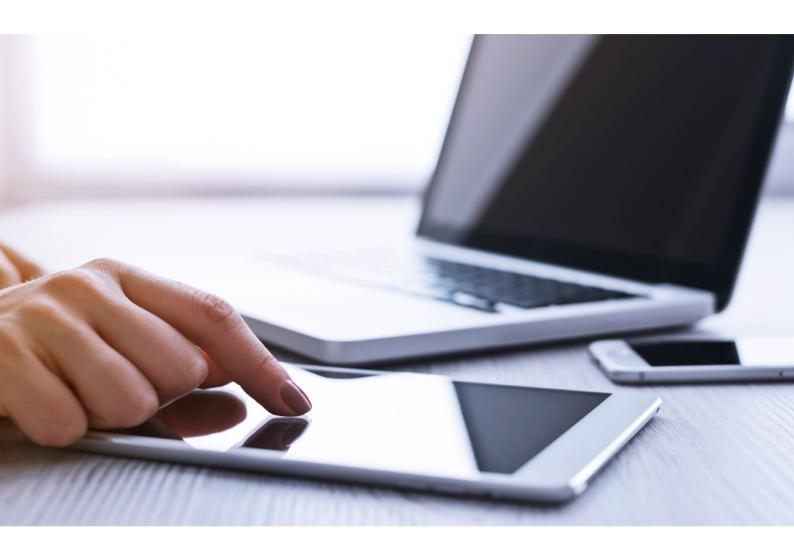
Heraeus



用于高性能SMT应用的无铅焊膏系列

针对SMT工艺要求严苛的应用而开发的卓越的焊膏系列

Microbond® SMT712免清洗焊膏系列采用先进的无铅焊膏配方,可确保卓越的印刷性能。

对于诸如智能手机或混合电路等要求苛刻的复杂电子产品应用,不含卤素助焊剂零配方具有足够的活性,可在空气氛围内确保优异的润湿效果。

019/ : HET-MarCom_HET24233-0824-5

Microbond® SMT712

适用于SMT应用

主要特点

- 可在空气回流内确保优异的湿润效果
- 低空洞率表现
- 稳定的大批量印刷性能
- 抗焊珠配方
- 超低透明助焊剂残留物
- 可有效的避免枕头效应

标准的产品规格

13.4 E E 21 HH 170 I H
SMT712 焊膏
免清洗型
不含卤素
4号和5号焊粉
ROL0
SAC305 合金

美洲地区

电话 +1 610 825 6050

electronics.americas@heraeus.com

亞太 电话 +65 6571 7649 electronics.apac@heraeus.com 中国 电话+86 53 5815 9601 electronics.china@heraeus.com 歐洲、中東和非洲 电话 +49 6181 35 4370 electronics.emea@heraeus.com